

## ***Progettazione Board***

- Massimo numero di fori: 500 x small, 2000 x big
- Grandezza dei fori: (0.7) (0.9) (1.0) (1.1) (1.3) (1.5) (2.1) (3.3) mm
- Fori per PCB double-side: -0.1mm finale da quello dichiarato
- Fori in millimetri e non pollici
- Silkscreen non sopra i pad
- Bordo della scheda con traccia da 10mils su tutti i layer
- Minima dimensione 20x20mm
- Dimensione massima PARI a quella del pannello
  
- Spessore minimo delle tracce: 8mil
- Distanza minima traccia/traccia, pad/pad, traccia/pad: 8mil
- Diametro minimo foro: 0.6mm
- Diametro massimo foro: 5.0mm
- Minimo spessore della corona del pad: 8mil
- Distanza minima fra foro/traccia e bordo: 20mil

## ***Pannellizzazione***

- Si può mandare un file per ogni board da pannellizzare, loro faranno la pannellizzazione, ma bisogna mandare un'immagine con la composizione da creare.
- Solo tagli dritti da parte a parte
- Almeno 2mm tra scheda e scheda